室温での加水分解反応による Cu_2O 膜形成

Cu_2O film formation by hydrolysis method at room temperature

学習院大学¹, 明治大学² ○(M2) 大山翔平¹, 渡邊匡人¹, 肥山卓矢², 横川凌², 小椋厚志²

Gakushuin Univ.¹, Meiji Univ.² ○S. Ohyama¹, M. Watanabe¹, T. Hiyama², R. Yokogawa², A. Ogura²

E-mail:15141005@gakushuin.ac.jp

1. はじめに

近年 Cu_2O は太陽電池材料や熱電変換材料として注目されており[1], 環境負荷の低い低温プロセスでの結晶成長方法が検討されている. 我々は, Cu 基板を塩酸でエッチング処理をしていたところ, Cu 基板の上に Cu_2O 結晶が成長することを見出した. このプロセスを詳細に調べたところ, Cu と塩酸の反応により生成した CuCl の加水分解反応により Cu_2O が生成されることがわかった. さらにこの反応を利用して Cu 基板の上に Cu_2O 膜を形成するためには温度制御が重要なことがわかり, Cu 基板の上に $10\ \mu\text{m}$ 程度の Cu_2O 膜を形成できるようになった.

2. 実験

$10\text{mm} \times 10\text{mm} \times 0.8\text{mm}$ の Cu 板(純度 99.96%)をアセトン, エタノール, 純水で洗浄し 5%塩酸に 5 分間浸した後, 純水中で超音波洗浄を 5 分間おこない, そのまま純水中で静置した. 保持温度を変えて一定時間静置した後, Cu 表面に形成した膜を X 線回折法(XRD), SEM および SEM-EDX と XPS により構造と組成を調べた.

3. 結果

Fig.1 XRD results of deposited films on Cu substrate under, (a) constant-temperature holding, (b) no temperature control conditions.

Fig.2 SEM image of Cu_2O films on Cu substrate deposited under constant temperature holding during 7 days holding

Fig. 1 は一定温度になるようにして制御して形成した Cu 基板上の膜 (a) と温度制御せずに形成した膜 (b) の XRD 結果である. 図中に, ○:Cu, □: Cu_2O , △: CuCl の記号でそれぞれの結晶のピークを示した. Fig. 1 (b) の温度制御なしの場合には, Cu 基板からのピークと CuCl , Cu_2O のピークが現れているが, Fig. 1 (a) の一定温度となるように保持した場合, Cu_2O のみのピークが観られ Cu_2O 単相の膜ができていることがわかる. この Cu_2O 膜形成メカニズムは, 塩酸に Cu 基板を浸した際に, Cu 表面で塩酸と Cu が反応し CuCl を形成し, 純水に移したことで, $2\text{CuCl} + 20\text{H}^- = 2\text{Cl}^- + \text{Cu}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$ [2] の加水分解反応により Cu_2O が生成したと考えられる. 一定温度に保持することで, Cu_2O が形成される加水分解の方向のみに反応が進み Cu_2O 単相膜が形成できたと考えられる. Fig. 2 は塩酸に浸してから 7 日後の Cu 基板上の Cu_2O 膜の SEM の反射電子像である. Cu 基板表面は見え, Cu_2O が表面全体を覆っていることがわかり Cu 基板の上に Cu_2O 単相膜を形成できることが確認できた. 発表では Cu_2O 膜のモルロジーについても議論する.

[1] W. Cyrus *et al.*, Environmental Science & Technology 43.6 (2009): 2072-2077.

[2] H. Liu *et al.*, J. Mater. Chem. A, 2013, 1, 302-307